

# 回收整流桥-回收IGBT模块-回收可控硅

产品名称	回收整流桥-回收IGBT模块-回收可控硅
公司名称	华合微电子商行
价格	99.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区华强电子一期
联系电话	13248223338 13248223338

## 产品详情

长期高价回收IGBT模块，回收可控硅，回收整流桥，回收英飞凌IGBT模块 回收富士FUJI模块 大功率模块 回收IGBT功率模块 高价收购IR品牌模块 意法半导体模块 仙童模块 三肯IGBT模块 三菱模块 IXYS模块

品牌：INFINEON/英飞凌

型号：FF200R12KT4

类型：电源模块

电源电流：200A

电源电压：1200V

功率：8-20KHZ

用途：MOS-HBM/半桥组件

公司回收涉及到的品牌有：英飞凌、优派克、ABB、三菱、东芝、富士、三社、艾赛斯、仙童、艾默生、三肯等

第三是罐封技术，如果IGBT应用在高铁、动车、机车上，机车车辆运行过程中，环境是非常恶劣的，我们可能会遇到下雨天，遇到潮湿、高原，或者灰尘比较大，如何实现IGBT芯片与外界环境的隔离，实现很好运行的可靠性，它的罐封材料起到很重要的作用。就要求选用性能稳定无腐蚀，具有绝缘、

散热等能力，膨胀率小、收缩率小的材料。我们大规模封装的时候，填充材料的部分加入了缓冲层，芯片运行过程中不断加热、冷却。在这个过程中如果填充材料的热膨胀系数与外壳不一致，那么就有可能造成分层的现象，在IGBT 模块中间加入一种类似于起缓冲作用的填充物，可以防止分层现象出现。

IGBT 模块封装是将多个 IGBT 集成封装在一起，以提高 IGBT 模块的使用寿命和可靠性，体积更小、效率更高、可靠性更高是市场对 IGBT 模块的需求趋势，这就有待于 IGBT 模块封装技术的开发和运用。目前流行的 IGBT 模块封装形式有引线型、焊针型、平板式、圆盘式四种，常见的模块封装技术有很多，各生产商的命名也不一样，如英飞凌的 62mm 封装、TP34、DP70 等等。